



Produktbereiche

Leiterplattenherstellung

☑ Galvanische Zusätze und Verfahren für die Herstellung von Leiterplatten

☒ Innenlagenbehandlung

- ☒ Schwarz Oxid auf Basis Chlorit
- ☒ Braun Oxid auf Basis Wasserstoffperoxid

☒ Bohrlochreinigung, 3-Stufen-Prozeß

- ☒ Queller (verschiedene Systeme für normal und high Tg-Materialien)
- ☒ Permanganat (Natrium oder Kalium)
- ☒ Neutralizer (mit oder ohne Glasfaserkonditionierung)

☒ Konventionelle Durchkontaktierung mit chemisch Kupfer (horizontal / vertikal)

- ☒ Basierend auf Weinsäure oder Quadrol als Komplexbildner
- ☒ Abscheidungsraten zwischen 1,2 und 6,0 $\mu\text{m/h}$

☒ Elektrolytisch Kupfer (horizontal / vertikal)

- ☒ Vertikal DC, lösliche Anoden
- ☒ Vertikal Pulse, lösliche Anoden
- ☒ Horizontal DC, unlösliche Anoden
- ☒ Horizontal Pulse, unlösliche Anoden

☒ Elektrolytisch Zinn

- ☒ Basierend auf Methansulfonsäure
- ☒ Seidengänzende Abscheidung

Quelle: <http://www.icb-germany.de/leiterplattenherstellung>

☑ Kontakt

ICB GmbH & Co. KG

→ Ludwig-Erhard-Ring 21

D-15827 Dahlewitz

Tel: +49-33708-5002-0

Fax: +49-33708-5002-40

Email: info@icb-germany.de
